E5-01015-YK (2)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-300600

(43) Date of publication of application: 07.12.1988

(51)Int.CI.

H05K 13/04

(21)Application number : 62-137407

(71)Applicant: FUJI KIKAI SEIZO KK

(22)Date of filing:

(72)Inventor: ASAI KOUICHI

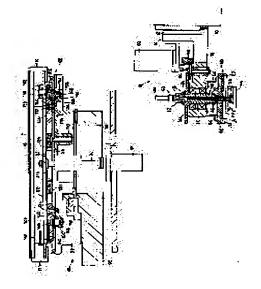
TSUDA MAMORU

KODAMA JIRO

(54) METHOD AND APPARATUS FOR MOUNTING ELECTRONIC COMPONENT

PURPOSE: To avoid the decrease in an electronic component mounting efficiency and to eliminate a damage by substantially maintaining the falling distance of a suction nozzle constant irrespective of the height change of the component. CONSTITUTION: Compression coil springs 140, pistons 146, air chambers 158 and air supply units form height regulators 128. As a lower frame 84 moves up or down, an upper frame 82 placed thereon moves up or down to adjust elevational position with respect to a Y-axis slide 92 of a table 80, thereby altering the elevational position of a printed substrate 4 supported by the frame 82. The height of the table 80 is adjusted in advance in coincidence with the height of an electronic component 44. When an electronic component having a low height is mounted on the printed substrate 4, the table 80 is positioned at its raised position, while when an electronic component having a high height is mounted on the substrate 4, it is positioned at its lowered position. According ly, a spring 46 is compressed to apply a pressing force to the component 44, but not excessively compressed to prevent the component 44 from damaging or displacing.

29.05.1987



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DUST NATE TO THE SHIP

E5-01015-YK (2)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-300600

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月7日

H 05 K 13/04

B-6921-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

毎発明の名称

電子部品装着方法および装置

②特 頤 昭62-137407

②出 頤 昭62(1987)5月29日

⑫発 明 者

砂発

'井 漤

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械製造株式会社内

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械製造株式会社内

眀 砂発 明 老

玉

護 次 郎

愛知県知立市山町茶碓山19番地 富士機械製造株式会社内

切出 願 人

富士機械製造株式会社

愛知県知立市山町茶碓山19番地

②代 理 弁理士 神戸 典和

外2名

1. 発明の名称

電子部品装着方法および装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 貧子部品を吸着した吸着ノズルを下降させ、 プリント基板の電子部品装着箇所に電子部品を装 着する方法であって、

電子部品の高さが高い場合には前記吸着ノズル の下降開始位置の前記プリント基板からの距離を 大きくし、電子部品の高さが低い場合には距離を 小さくして、電子部品をプリント基板に装着する ための吸着ノズルの下降距離を電子部品の高さ変 化にかかわらずほぼ一定とすることを特徴とする 位子部品装着方法。

(2) 電子部品をパキュームにより吸着した状態で 下降させられ、電子部品をプリント基板の電子部 品装着箇所に装着する吸着ノズルを備えた電子部 品保持装置と、

テーブルによりプリント基板を支持するプリン ト基板支持装置と

を備えた電子部品装着装置において、

前記テーブルを上下方向に移動可能に設けると ともに、そのテーブルの高さを調節する高さ調節 装置を設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、電子部品をプリント基板に装着する 方法およびその方法の実施に使用される装置に関 するものである.

従来の技術

電子部品をプリント基板に装着する装置には、 本発明の出願人による特願昭60-281596 号の明細書に記載されているように、ほ子部品保 持装置とプリント基板支持装置とを含むように構 成されるものがある。この出願において電子部品 保持装置は、電子部品をバキュームにより吸着す る吸着ノズルを備え、この吸着ノズルがプリント 基板の電子部品装着箇所の真上に位置させられた 状態で下降させられ、電子部品をプリント拡板に 装着するものとされ、プリント基板支持装置は、

特開昭63-300600(2)

移動装置によって移動させられるテーブルにより プリント基板を支持し、そのテーブルの移動によ りプリント基板を所定の位置、すなわち電子部品 が装着される箇所が吸着ノズルの真下に位置する ように位置決めするものとされている。

また、プリント基板支持装置が、プリント基板 をテープルにより予め定められた一定位置に支持 ものとされ、電子部品保持装置が、プリント基板 の板面に平行な方向に吸着ノズルが移動させられ て電子部品装着箇所の真上に位置決めされるよう に構成された電子部品装着装置や、電子部品保持 装置が、吸着ノズルが電子部品を吸着した状態で プリント基板の電子部品装着箇所に向かって移動 させられつつ下降させられ、電子部品をブリント 基板に装着するようにされた電子部品装着装置も

この種の電子部品装着装置においては、従来、 吸着ノズルの下降開始位置とプリント基板との上 下方向の距離が一定とされるとともに、吸着ノズ ルの下降ストロークが一定とされ、それらの調節

は行われていなかった。

発明が解決しようとする問題点

そのため、次に述べるような種々の問題が生じ ていた。

例えば、電子部品が高さの高いものであり、吸 着ノズルとプリント基板との距離の方が小さい場 合には、その高い電子部品を装着することができ ない問題が生ずる。この場合、吸着ノズルとブリー ント基板との距離を大きくすれば高い電子部品も 装着することができるのであるが、そのようにす れば高さの低い電子部品を装着する際にも吸着ノ ズルを大きなストロークで下降させなければなら なくなって装着能率が悪化してしまう。

また、電子部品保持装置においては、電子部品 をプリント基板に確実に装着するために吸着ノズ ルの下降ストロークを吸着ノズルに吸着された電 子部品とブリント基板との距離より大きくすると ともに、吸着ノズルとそれを保持する部材との間、 あるいは吸着ノズルの先端部と本体部との間に弾 性部材を設け、その弾性部材の提みにより余分な

下降ストロークを吸収するようにすることが多い。 その場合、高さが異なる複数種類の電子部品をプ リント基板に装着する際には、高さの小さい電子 部品に合わせて吸着ノズルの下降ストロークを設 定することとなるのであるが、電子部品が高さの 高いものである場合には弾性部材により吸収され るストロークが大きくなる。吸着ノズルの下降距 題は電子部品が高さの低いものである場合の下降 距離より小さく、その差を吸収する分、弾性部材 の提み畳が大きくなるのであり、電子部品に加え られる押圧力が大きくなり、電子部品が損傷する 恐れが生ずる上、電子部品がプリント基板に装着 される際のプリント基板の狼みが大きくなって扱 動が大きくなり、装着後の電子部品の位置がずれ てしまうこともある。

さらに、吸着ノズルがカムを傭えた押下装置に より上下動させられ、下降開始当初下降速度は速 く、電子部品がプリント基板に接触する際の下降 速度は遅くなるようにされている場合には、電子 部品が高いものである場合に電子部品が高速でプ リント基板に衝突させられることとなるため、接 触時に生ずる衝撃が大きく、電子部品やプリント **基板等が損傷する恐れが強くなるという問題があ**

問題点を解決するための手段

上記種々の問題を解決するために、本発明に係 る方法は、電子部品を吸着した吸着ノズルを下降 させ、プリント基板の電子部品装着箇所に電子部 品を装着する方法であって、電子部品の高さが高 い場合には吸着ノズルの下降開始位置のプリント 基板からの距離を大きくし、電子部品の高さが低 い場合には距離を小さくして、電子部品をプリン ト基板に装着するための吸着ノズルの下降距離を 電子部品の高さ変化にかかわらずほぼ一定とした ものである。下降開始位置とプリント基板との距 組を変えるためには、プリント基板の高さを変え ても、吸着ノズルの下降前における高さを変えて もよい.

また、本発明に係る装置は、前記回電子部品を バキュームにより吸着した状態で下降させられ、

特開昭63-300600(3)

電子部品をブリント基板の電子部品装着箇所に装着する吸着ノズルを偏えた電子部品保持装置と、(ロ)テーブルによりブリント基板を支持するブリント基板支持装置とを備えた電子部品装着装置において、テーブルを上下方向に移動可能に設けるとともに、そのテーブルの高さを調節する高さ調節装置を設けたものである。

作用および効果

本発明に係る方法におけるように、吸著ノズルの下降距離を電子部品の高さ変化にかかわらずほ は一定とすれば、高さが低い電子部品の装着能率 の低下を回避しつつ高さの高い電子部品の装着を可能とすることができる。

また、吸着ノズルの余分な下降ストロークが弾性部材により吸収されるようにした場合には、吸着ノズルの下降ストロークがほぼ一定とされることにより弾性部材の提み量がほぼ一定となり、電子部品がプリント基板に過大な押圧力で押し付けられることがなくなって損傷等が生ずる恐れがない上、プリント基板の提みが少なくなって振動が

少なくなり、電子部品の位置ずれが生ずる恐れが なくなる。プリント 基板の換みが少なくなること により、それの支持装置が簡易なもので待む効果 も得られる。

さらに、吸着ノズルをカムを備えた押下装置によって上下動させる場合に、高さの高い電子部品がプリント基板に接触する際の衝撃も小さくて済み、電子部品等に損傷等が生ずる恐れがない。

本発明に係る装置によれば、本発明の方法を実施することができる他、吸着ノズルの高さを調節する場合に比較してプリント基板と吸着ノズルとの距離の変更が容易となる効果が得られる。吸着ノズルを含む電子部品保持装置側は可動部が多くなるのが普通であるため、これら可動部の作動に支障を来さない形態で吸着ノズルの高さを調節可能とすることが困難な場合が多いのに対してプリント基板を支持するテーブルの高さを調節する場合はそのような問題が少ないのである。

実施例

以下、本発明に係る方法および装置の実施例を

図面に基づいて詳細に説明する。

プリント基板 4 には、第3 図に示される電子部品保持装置 8 により電子部品が装着される。この保持装置 8 は、本出願人の出願である実願昭 6 2 - 5 1 5 1 2 号に係る保持装置とほぼ間じ構成のものであり、図面に基づいて簡単に説明する。

図において10は回転体であり、この回転体1

吸着ノズル18は、スリーブ20に回転不能かつ動方向に移動可能に 联合された本体22とと、その本体22に一体的に 联合された吸着管24とを傾えている・吸着管24はナット32によって気 値は22に固定されており、その中心部には 空気 値路34が形成されている・この空気 通路34は トット32にパキュームホース38が接続金具40によって接続されることにより、図示しないバ

特開昭63-300600(4)

キューム源に接続されており、バキューム源に設けられた電磁方向切換弁が切り換えられるのに伴って、吸着等24が先端の吸着部42において電子部品44を吸着したり、解放したりする。

また、吸着ノズル18は、スリープ20に設けられた大径のギヤ50が小径ギヤ52,中径ギヤ

するテーブル80を備えている。このテーム88とでいる。このテーム88とでいる。このテーム88とでいる。ロフレーム888ででは、NCスライな88を備えている。NCスライな移動方向に移動するとでは、NCスライド88は、Y軸方のに移動するとでは、Y軸スライド90ととを備えてディークを動になる。NCスライド90ででは、NCスライド88が移動されるのを動には、NCスライド88が移動されるのを動には、NCスライド88が移動にである。NCスライド88が移動にである。

上部フレーム 8 2 には、一対のガイドロッド 9 4 は、下部フレーム 8 4 に設けられた開口 9 6 を通って Y 軸スライド 9 2 に搭動可能に嵌合されるともに、 X 軸スライド 9 0 に設けられた開口 9 8 か内へ延び出させられている。上部フレーム 8 2 はガイドロッド 9 4 により Y 軸スライド 9 2 に係合させられているのであり、ガイドロッド 9 4 がシリ

5 4 . 駆動ギャ 5 8 を介してサーボモータ 6 0 によって回転させられることにより、スリーブ 2 0 と共に回転させられるようになっている。

前記プリント基板支持装置 2 は、第1図および 第2図に示されるように、プリント基板 4 を支持

ンダ99によって昇降させられることにより、下 部フレーム84・スライド90・92に対して対 近・難間させられる。上部フレーム82は、対 フレーム84から離間して前記プリント基 でで発置と同じ高さに位置し、プリー での受渡しを行う上昇位置と、それより一定距離 下方であって第2図に示されるように下部 ム84に密着し、 協入 装置、 設出 装置と で ことなく電子部品の装着が為される下降位置との で移動させられるのである。

上部フレーム82にはまた、第2図に示されるように、プリント基板4をその送り方向に平行な 両縁部において支持する固定支持部材100. 可動支持部材102. プリント基板4を正確に位置 決めする主位置決め部材104. 勘位置決め部材100. 可動支持部材102. 主位置決め部材104. 副位置決め部材104. 副位置決め部材106は、前記特別昭61-168299号公報に記載されているものと同じ 構成のものであり、ここでは簡単に説明する。

特開昭63-300600(5)

固定支持部材100は、上部フレーム82のプ リント基板送り方向に平行な2辺のうち、一方の 辺の両端部に固定のブラケット110およびその プラケット110により支持された固定ガイド1 12を備えている。また、可動支持部材102は、 上部フレーム82の他方の辺の両端部に取り付け られ、前記 Y 軸方向に移動可能なスライド 1 1 4 およびそれらスライド114によって支持された 可動ガイド116を備えている。両スライド11 4 はそれぞれ、クランプ機構(図示省略)により 上部フレーム82に移動不能に係合させられる― 方、クランプ解除機構によりその係合を解除され、 Y軸方向への移動が許容されるようになっており、 搬入装置、搬出装置の幅の調節に伴って移動させ られ、可動ガイド116と固定ガイド112との 距離がプリント基板4の幅に合わせて調節される ようになっている。

また、主位置決め部材104および割位置決め 部材106は、それぞれプリント基版4に設けら れた位置決め孔に嵌合する位置決めピン120.

て上下方向に移動可能に設けられるとともに、それら下部フレーム84とY軸スライド92との間にはテーブル80の高さを調節する高さ調節装置128が設けられている。

下郎フレーム84には、第1図に示されるよう に一対のガイドロッド130が下方に延び出す向 きに固定されており、それらガイドロッド130 はY軸スライド92に軸方向に摺動可能に篏合さ れている。下部フレーム84は、ガイドロッド1 30によりY軸スライド92に係合させられてい るのである。下部フレーム84にはまた、上下方 向に延びる質遣孔132が4個(第2図参照)設 けられており、各貫通孔132にそれぞれY軸ス ライド92上に立設された4本のねじ部材134 が挿入されている。ねじ部材134の上端に設け られた大径のフランジ部136と下部フレーム8 4の下面に固定のばね受け138との間には圧縮 コイルスプリング140が配設され、下部フレー ム84はY軸スライド92に接近する向きに付勢 されている。

122を有し、主位置決め部材104は、上部フ レーム82に固定して設けられる一方、剔位置決 め部材106は移動可能に設けられている。副位 置決め部材106は、Y軸スライド92に設けら れたガイドレール124に嵌合され、常にはクラ ンプ部材(図示省略)によってガイドレール12 4 に移動不能に係合させられる一方、そのクラン プ部材によるクランプがプリント基板支持装置と は別の固定部材に設けられたクランプ解除部材(図示省略) によって解除されるとともに位置固定 に保持されるようになっており、クランプ解除部 材によって保持された状態で上部フレーム82が X軸方向に移動させられることにより、その位置 がプリント基板4の位置決め孔の位置に合わせて 変えられるのである。なお、126は位置決めピ ンであり、固定支持部材100および可動支持部 材102に両端部を支持されたプリント基板4の 中央部を下方から支持する支持治具を位置決めす るために設けられているものである。

下部フレーム84は、Y軸スライド92に対し

下部フレーム84には、4個の有底穴144の 各々の底面とピストン146との間に形成された 空気室158と下部フレーム84の外面とをそれ ぞれ連週させる4本の通路160が設けられてお り、各通路160に図示しない空気供給装置にはな 続されるようになっている。空気供給装置には切 做方向切換弁が設けられており、その切換弁の切

特開昭63-300600(6)

換えにより、4個の空気室158が一斉に空気供 給装置あるいは大気に連通させられる。空気窒1 58が大気に連通させられた状態では、下部フレ ーム84はスプリング140により付勢され、ば ね受け138がY軸スライド92に当接する下降 位置に位置させられる。また、空気室158に空 気が供給されれば、下部フレーム84はスプリン グ140の付勢力に抗して上昇させられる。この 上昇はガイド部材150とピストン146とが当 接することにより規制される。

このような下部フレーム84の昇降に伴い、そのような下部フレーム82が昇降された上部フレーム82が昇降された上部フレーム82が昇降された上部フレーム80の対象では、上部フレース80の位置が調節されたプリント基板4のカーム82により支持されたプリント基板4のカーム82により支持されたプリントを担づつの圧縮立ているのであり、本実施例においての距離は、すなわち上昇位置と下降位置との距離は

3 mとされている。

なお、上部フレーム82上には、第1図に示されるように4隅にアジャストポルト162が螺合され、デーブル80の上下方向の位置を微調整し得るようにされている。テーブル80か水平面内において傾いている場合やテーブル80の高さが不適当である場合に、適宜のロックナット164を綴めた上、アジャストポルト162を回転させてテーブル80が水平となるように調節するのである。

また、本実施例において電子部品供給装置は、電子部品を保持したキャリヤテープを長手方向に沿って1ピッチずつ送るものとされ、電子部品は、その高さにかかわらず上面の位置がほぼ一定の状態で電子部品保持装置に供給されるようになっている。

以上のように構成された電子部品装着装置においては、テーブル 8 0 の高さは、装着される電子部品 4 4 の高さに合わせて予め調節される。高さの低い電子部品、例えば 0.4 ~ 1.2 ***のものをア

リント基板4に装着する場合には、テーブル80 は上昇位置に位置させられ、高さが高い電子部品、 例えば6mの電子部品をプリント基板4に接着す る場合には、下降位置に位置させられるのである。

そして、電子部品保持装置8は図示しない部品 供給装置から電子部品44を受け取り、摄像装置 によって電子部品44の位置を検出された残像な プリント基板4上へ移動するまでの間による撮像装置 アリント基板4上へ移動するまでの間にから 課差△0が修正されるとともに、プリント基板を 持装置2においてはNCスライド88が移動させ られ、前記中心位置誤差△X。△Yが修正的 が成で、プリント基板4の電子部品装着箇所が吸 者ノズル18の真下に位置するように位置決めさ れる。

吸着ノスル18はプリント基板4の電子部品装着箇所の真上に位置決めされた状態で下降させられ、電子部品44をプリント基板4に装着する。この際、テーブル80の位置が電子部品44の高さに合わせて調節されており、電子部品44が高

なお、上記実施例においてテーブル 8.0 は、上昇位置と下降位置との 2 位置に調節されるようになっていたが、更に細かく多段階に調節し得るようにしてもよく、無段階に調節し得るようにしてもよい。

また、本発明に係る方法を実施するに当たり、 プリント基板の高さを調節するのに代えて、吸着

特開昭63~300600(プ)

ノズルの高さ(下降開始位置)を網節するように
してもよい。そのようにすれば、例えば、ご子のようにすれば、例えばるのようにすれば、例えばるのように
はなることはなった。 なるとのできる。 吸着フェングできる。 でまることができる。 でままびですることにより、パレットおよびアリントを はの両方と吸着アルルとの 選挙を 国避 を ことができ、 電子部品の 損傷等を 国避 および 必ず といるの できるのである。また、プリント 基板 および よいの両方の高さを調節するようにしてもよい。

子部品装着装置等、上記実施例以外の電子部品装 着装置ならびにその装置による電子部品の装着に 適用することができる。

その他、いちいち例示することはしないが、高さ調節装置等に当業者の知識に基づいて種々の変形、改良を施した態様で本発明を実施することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る装置の一実施例である電子部品装着装置のブリント基板支持装置を示す正面図(一部断面)であり、第2図は平面図である。 第3図は上記電子部品装着装置の電子部品保持装置を示す正面図(一部断面)である。

2:プリント基板支持装置

4:プリント基板 8:電子部品保持装置

18:吸着ノズル 44:電子部品

46:圧縮コイルスプリング 80:テープル

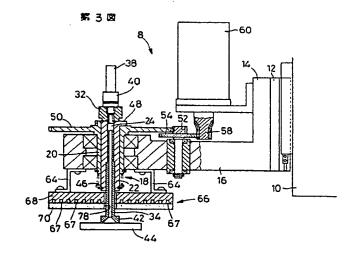
82:上部フレーム 84:下部フレーム

128:高さ調節装置

140:圧縮コイルスプリング

146:ピストン 158:空気室

出願人 富士機械製造株式会社 代理人 弁理士 神 戸 典 和 (ほか2名) 近地芸



特開昭63-300600(8)

